

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-173085

(43)公開日 平成10年(1998)6月26日

(51)Int.Cl.<sup>a</sup>  
H 01 L 23/12  
21/60

識別記号  
3 0 1

F I  
H 01 L 23/12  
21/60

F  
3 0 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平8-326522

(22)出願日 平成8年(1996)12月6日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝  
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 染野 邦明  
埼玉県深谷市幡屋町1-9-2 株式会社  
東芝深谷工場内

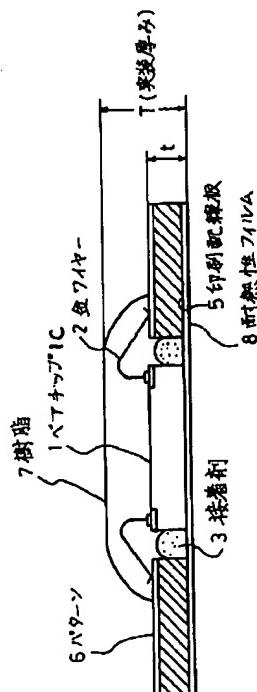
(74)代理人 弁理士 本田 崇

(54)【発明の名称】 電子モジュール及び電子モジュールの製造方法

(57)【要約】

【課題】 厚み規制がある電子モジュールにおいてもベアチップICの実装を容易として、前記電子モジュールの製造効率を向上させること。

【解決手段】 印刷配線板5の開口孔にベアチップIC1を接着剤3により固定して実装しているため、ベアチップIC1の実装厚みTは印刷配線板5の厚みtだけ薄くなる。このため、ベアチップIC1を上から封止する樹脂の厚みが、多少厚くとも、上記した実装厚みTは規制の厚みを余裕を持ってクリアーするため、上記した樹脂の封止工程を簡単化できる。このため、ベアチップICの実装が容易となって、電子モジュールの製造効率が向上される。



Best Available Copy